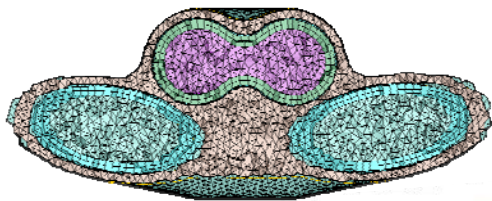


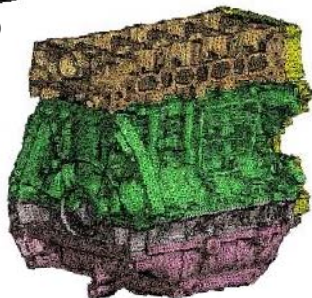
TSVユーザー会2010

部品モデル規模から大規模まで対応可能 国産 CAE汎用プリ・ポストソフトウェア / カスタマイズも随時承ります



開発版/レイヤーメッシュ(層メッシュ)

- 外層 テトラ
- 中層 ヘキサ
- 内層 テトラ



アセンブリ機能

- 500万自由度アセンブリメッシュモデル
- 工数2h (モデル読込~アセンブリメッシュ)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、来る2010年9月22日(水)に 株式会社テクノスター主催、株式会社富士通九州システムズ他協賛により「TSVユーザー会2010」を開催する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

今回のユーザー会では初の試みとして、ユーザー様より TSV-Pre, Post, Designer 製品による適用事例講演と製品情報を合わせた15コマの分科会形式で開催いたします。

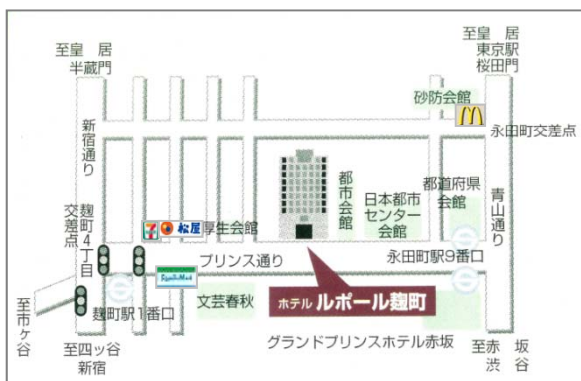
ご来場の皆様には有意義なユーザー会となるよう努力してまいり所存でございますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

ご多忙中とは存じますがご来場を賜りますよう、心よりお待ち申し上げます。敬具

株式会社富士通九州システムズ (FJQS)
※FJQSは TSV製品の販売代理店です。

開催概要

日時	2010年 9月 22日(水) 13:00 開始 ※12:50 までにご入場をお願いします。司会より事前説明がございます。 12:20 受付開始 13:00~17:30 講演時間 17:40~19:10 懇親会				
会場	ホテル ルポール麹町 東京都千代田区平河町2-4-3 tel: 03-3265-5365 (地図) http://www.leport.jp/map/acsses_b.html				
費用	無料 (事前Webお申し込み制。当日はお名刺を1枚ご持参ください) ※ご参加はユーザー様限定ではございません。 当日はTSVの開発、サポート、トレーナー各エンジニアも出席いたします。この機会にご質問や技術情報交流の場としてご懇談ください。				
プログラム (第1部)	「TSV-Pre, Post, Designer 最新の開発機能デモンストレーションと開発ロードマップ」 <ul style="list-style-type: none"> TSV-Solutions 最新バージョンご紹介 設計者向けCAE (Designer向けTSV) Reverse Engineering (CCD, CT計測結果のNurbs化) 新中立面抽出機能(樹脂流動解析、Crash、強度、NVHなどへの適用) 板金構造の効率的モデリング <ul style="list-style-type: none"> 最適化プログラムとの連携(CAD⇒FEM(最適化)⇒CAD) 非線形 周波数応答解析対応ソルバー T-CAD(船体構造最適化システム) き裂解析システム など 				
プログラム (第2部)	(自動車)	本田技術研究所 様 菊池プレス工業 様	マツダ 様 旭テック 様	スズキ 様 小糸製作所 様	横浜ゴム 様 デンソーアイテック 様
ユーザー様事例講演	(電機)	富士ゼロックス 様	ブラザー工業 様		
	(造船)	川崎造船 様	ユニバーサル造船 様	広島大学 様	
	(設計者向けCAE)	神鋼テクノ 様		(製品情報) エムエスシーソフトウェア 様	
主催	株式会社テクノスター				
協賛	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社		株式会社富士通九州システムズ		※50音順
概要・申込	http://www.e-technostar.com/forum/201009/index.html				



【会場のご案内】

ホテル ルポール麹町

東京都千代田区平河町2-4-3 tel: 03-3265-5365

http://www.leport.jp/map/acsses_b.html

<http://www.leport.jp/restaurant/index.html>

※アクセス

※ホテル内ご昼食向き飲食店(B1)、喫茶店(1F)のご案内

- 有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩3分
- 有楽町線・半蔵門線「永田町駅」5番出口より徒歩5分
- 南北線「永田町駅」9b番出口より徒歩5分
- 丸の内線・銀座線「赤坂見付駅」D番出口より徒歩8分
- ※東京、上野、渋谷、新宿の各ターミナル駅より 乗り換え含み 約20分

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

TSVユーザー会2010プログラム

12:50 までにご入場をお願い申し上げます。司会より事前説明がございます。

13:00	国産CAEソフト「TSV-Pre, Post, Designer」最新の開発機能デモンストレーションと開発ロードマップ / 株式会社テクノスター			
	自動車 分科会	一般製造業 分科会	造船・Designer 分科会	中立面機能 分科会
14:25 15:05	スズキ株式会社 デジタル技術部 畑 大輔 様 【FEMモデル作成自動化への取り組み(ボルト締結、及び溶接部のモデル化)】 解析工数の削減および解析モデルの標準化を目的とし、解析モデル自動作成システムの開発を進めている。その一環として、TSVによる構造解析用ボルト締結モデルとアーク溶接モデルの自動作成機能を開発した。自動化の概要および効果について紹介する。	エムエスシーソフトウェア株式会社 ビジネスデベロップメント部 部長 立石源治 様 【MSCでの大規模並列解析への取り組み及びTSVを用いた大規模並列解析事例のご紹介】 MSCではHPCを戦略的開発項目の一つに位置付けております。そこで今回の講演ではMSCの目指すHPCの概要、将来像などをご説明するとともに、すでに実装しているHPC機能の紹介を行います。また、この分野で多くのユーザーに支持されているTSVをプリポストとして活用した並列計算解析事例も合わせてご紹介いたします。	神鋼テクノ株式会社 総務室 技術企画グループ CAD運用担当 大山誉実 様 【設計者によるCAE活用 ICAD/SX+TSV】 最近、3D-CADによる設計が脚光を浴びているが、当社ならびに神戸製鋼所 機械事業部門においても例外ではなく、フル3D設計を目指し全社的な導入に向け、取組んでいる。3D-CAD設計のメリットとして、データを活用し設計品質の向上が図れる点が挙げられるが、そのひとつにCAEがある。設計者自ら3D設計を行い、設計初期段階でCAEを活用することでフロントローディングの実現を目指す。今回はCAD、CAEソフトの選定するまでの経緯、実務で取組んだCAE事例を紹介する。	株式会社デンソーアイテック 開発2部 副部長 谷本功一 様 【(仮題) TSVによる 中立面自動抽出の実現と工数削減結果】 (仮概要 ※詳細は追記公開準備中) デンソー アイテック でのTSVの導入目的と解析事例。
15:10 15:50	旭テック株式会社 軽合金事業本部 設計部 解析グループ 久保田義史 様 【旭テックにおける、TSV-Pre・Postの活用事例】 弊社における、鋳物(主に乗用車用ホイール)の構造設計段階におけるCAEツールの活用事例を主に、実際の業務での「TSV-Pre・Post」の使用状況や導入の目的・現状について発表致します。	菊池プレス工業株式会社 技術本部 開発部 開発ブロック 鈴木 宗 様 【プレス成形シミュレーション活用事例対策結果の表現手法について】 弊社では薄板鋼板のプレス成形シミュレーションで大きな課題となっていたスプリングバックの予測精度向上に取り組んできた。予測精度の高まりは事前検討の実用性を向上させその必要性を再認識させるに至った。対策の表現(モデリング)と確認作業の為、解析業務は増える一方である。表現手法であるCADモデリングにかかる工数は計算時間以上となることもあり、確認作業の一つであるシミュレーションの事前準備の手間と時間が問題となる。この問題を改善する方法についての検討事例をご紹介します。	株式会社川崎造船 技術本部 基本設計部 構造計画グループ 原 純哉 様 【3D-CAD(AVEVA) + TSV を用いた船舶構造設計作業合理化】 船体Hold部構造の基本設計において、3D-CAD(AVEVA)とTSVを用いて迅速なFEM計算を行うことで、従来よりも効率的に多数の構造検討を行うように出来るかの検討を行った。本ユーザー会ではその検証結果について紹介する。	ブラザー工業株式会社 開発企画部 技術グループ 主任研究員 工学博士 岩田尚之 様 【ブラザー工業でのTSV中立面機能の効果と課題】 ブラザー工業で開発設計しているプリンターは積極的な樹脂化が特徴となっている。筐体小型化を追求しているためシステムレベルでの解析検討が前提になってきている上に、樹脂部品は形状の複雑化が進んでいる。そのためCAEによる早期の品質確保をする上で解析業務の負荷軽減と解析精度維持は厳しい課題となっている。
16:05 16:45	マツダ株式会社 パワートレイン開発本部 主査 原田靖裕 様 【超大規模非線形解析システムによる エンジン本体系の強度解析について】 エンジン本体系の強度開発は、開発の短期化を実現する上での重要課題となっています。実用的期間内に高精度な非線形解析を実施すべく、TSVとADVENTUREClusterを組み合わせた、超大規模解析対応システムを構築しました。その活用事例についてご紹介いたします。	横浜ゴム株式会社 タイヤ研究開発部 CAE研究室 研究室長 工学博士 小石正隆 様 【メッシュフリー・ガラーキン法による フィラー充填ゴムとスチールコード補強ゴムの解析】 弊社では、ナノスケールの特徴構造を有するゴム材料とタイヤとのマルチスケール・シミュレーションの研究開発と、その商品開発への適用を進めている。講演では、TSVで作成した不均質な材料モデルを用い、メッシュフリー・ガラーキン法で解析した事例を紹介する。	国立大学法人 広島大学 大学院工学研究科 社会環境システム専攻 助教 田中智行 様 【シェルソリッド混合解析を用いた船体構造の疲労強度解析および破壊力学解析】 本講演では、TSV-Preの半自動MPC機能を用いた簡単かつ高精度なシェルソリッド解析について示し、本機能を船体構造の疲労強度解析および破壊力学解析に適用した事例について報告する。	株式会社小糸製作所 生産本部 生産技術開発部 成形・表面処理グループ 技師補 山本彰則 様 【金型製作費用低減を狙った、流動解析実施率の向上】 成形不具合を事前予測する流動解析の実施率を向上させ、金型費を低減するという取り組みを行っている。実施率向上のため、工数的なネック工程である解析モデル作成を、自動中立面作成機能を活用することで工数低減した。
16:50 17:30	株式会社本田技術研究所 二輪R&Dセンター管理室 開発支援ブロック 研究員 齋藤淳也 様 【二輪車のクランクケース強度評価におけるTSVの適用】 軽量・高出力化された二輪車用エンジンは、試作段階で破損が発生することがあり、線形解析では評価出来ない現象は実機での耐久試験評価が一般的であった。TSVを用いた大規模非線形解析技術を構築したことにより、エンジン全体の強度が机上評価可能となった。	富士ゼロックス株式会社 商品開発本部 プロセスイノベーション部 高橋英俊 様 【TSVを利用した解析作業の効率化】 弊社では、開発プロセス改革の一環として、複写機/プリンタのフレーム構造物の解析を設計の初期段階で実施している。従来はこの解析モデルの作成に数週間以上かかっていた。対策として、TSVとAdventure Clusterを利用し、フレーム構造物の作成工数を大幅に削減するスキームを構築した。これらの取り組みについて報告する。	ユニバーサル造船株式会社 商船・海洋事業本部基本設計部 構造設計室 総括スタッフ 三浦康史 様 【(仮題) TSVをベースとした揚重システム】 (仮概要 ※詳細は追記公開準備中) ユニバーサル造船でのTSVをベースにした揚重問題に対する取り組みについて。	※ 懇親会設営のため ご入場できません
17:40	懇 親 会(無料)			

TSVユーザー会2010事務局 / 株式会社テクノスター

〒106-0032 東京都港区六本木2-2-5M21ビル

tel : 03-3583-7333 fax : 03-3583-7345

email : tsv2010@e-technostar.com url : <http://www.e-technostar.com>

TSV 販売代理店

株式会社富士通九州システムズ(FJQS)

〒814-8589 福岡市早良区百道浜2-2-1

(富士通九州R&Dセンター)

tel : 092-852-3266(直通) / fax : 092-852-3074

email : fjqs-tsv@cs.jp.fujitsu.com